

RESUMEN DE LA INVENCION

Un módulo de chip (40a, 40b, 62) se divulga como que incluye un chip de circuito integrado (IC) (34, 64), una primera capa de sustrato flexible (18) con un número de agujeros (28), una segunda capa de sustrato adhesivo (16) con un número de agujeros (26), y una tercera capa de sustrato (14) hecha de un material eléctricamente conductor, la segunda capa de sustrato se intercala entre la primera y la tercera capas de sustrato y se acopla fijamente a las mismas, los agujeros de la primera capa de sustrato y los agujeros de la segunda capa de sustrato están alineados entre sí para formar un número de cavidades (12, 66) cada una recibiendo al menos una parte del chip IC.